

## 第14回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 28 年 7 月 11 日(月) 10:30~16:35

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室 (東京都中央区)

時間	題 目	講演者
10:30~ 11:55	司会 出田 吾朗 (三菱電機(株))	
	『低温焼結性金属微粒子の創製と利用』 (45 分)	北海道大学 ○米澤 徹
	『MO 技術及び低弾性化技術を用いた 低温焼結性ナノ銀ペースト』 (40 分)	ナミックス(株) ○佐々木 幸司、水村 宜司
11:55~ 12:55	昼 食 休 憩	
12:55~ 13:05	委 員 会 議 事	
13:05~ 14:25	司会 岩田 剛治 (大阪大学)	
	『合成分散剤を用いて調製する銅ナノ粒子 分散体とその焼成物の特性』 (40 分)	DIC(株) ○佐野 義之
	『Sn-Ag-Cu-Ni 系はんだによる噴流はんだ付 けにおける微小量の固相がはんだ付け性に及 ぼす影響』 (40 分)	三菱電機(株) ○重田 晃二、岩田 典也、出田 吾朗、 宮本 照雄
14:25~ 14:35	休 憩	
14:35~ 16:35	司会 松岡 洋 (日本電気(株))	
	『エレクトロマイグレーションによるはんだ接続部 の断線現象』 (40 分)	NECプラットフォームズ(株) ○田辺 一彦、戸島 寛
	『In-Snはんだの微細接合部におけるエレクト ロマイグレーション挙動』 (40分)	大阪大学 大藪 悟志、佐藤 茜、上西 啓介 (株)富士通研究所 ○上村 泰紀、作山 誠樹
	『何時までたっても無くならないエレクトロケミカ ルマイグレーション(ECM)による事故、その 原因と対策について』 (40 分)	リサーチラボ・ツクイ ○津久井 勤

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。